

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 05129181 A

(43) Date of publication of application: 25.05.93

(51) Int. Cl

H01L 21/027 G03F 7/20

(21) Application number: 03289916

(22) Date of filing: 06.11.91

(54) EXPOSURE APPARATUS

(57) Abstract:

PURPOSE: To improve the throughput of an exposure apparatus without decreasing an alignment accuracy by providing a second chamber separately from a first chamber, and so constituting it that environmental conditions around a photosensitive substrate contained in the second chamber can be arbitrarily controlled.

CONSTITUTION: A plate carrier PC_1 containing a glass plate PT to be conveyed to an exposure processor PE is contained in a subchamber SC separately from a main chamber MC containing the processor PE so as to substantially shut OFF from the atmosphere. A chamber controller controls environmental conditions in the subchamber SC and particularly the temperature, and the temperature of the plate PT in the carrier PC_1 is set to a predetermined value. Thus, the temperature of the plate PT before being conveyed to the processor can be set to an optimum temperature, i.e., substantially equal to the temperature of a plate stage PS, and an exposure operation for the plate can be started immediately in the processor.

(71) Applicant: NIKON CORP

(72) Inventor: NAKAKOJI YOSHIFUMI

COPYRIGHT: (C)1993.JPO&Japio

Fig. 15 MR 1M5

Sci. 14 Sci. 15 MR 1M5

Sci. 15 MR 1M5

Fig. 15

· Be Hallettan (JP) · · · · · · · · · · · 公開特許公報 A

311-特許出願企問訴与

特開平5-129181

(43) 公開日 - 平成5年 (1993) 5月25日

1875 1875	(51 Int.Cl. HOYL 21 027	ant Grant B	与均整理番号	FI			挟	तातुः । विशेषा
(21)出願番号 特願43~289916 (71)出願人 000004112 株式会社ニコン 株式会社ニコン 東京都千代田区もの内3 丁目2番3号 (72) 発明者 中小路 佳史 東京都品田区西大サ1 丁目6番3号 株式会社ニコン大井製作所内		<u>621</u>	7352 ~4M	HoIL 21 30	1			
(21) 出願番号 特願平3 + 289916 (71) 出願人 000004112 (22) 出顧日 平成3年(1991) 11月6日 東京都千代田区丸の内3 万目2番3号 (72) 発明者 中小路 住史 東京都品川区西大サ1 万日6番3号 株式会社ニコン大井製作所内					在动水	長請求	請水項の数3	(名7頁)
(70) 発明者。中小器。佳史 - 東京都品川区西大井 1 月日 6 番 3 号。株式 - 会社ニーン 大井製作所内				(71) 出懶人				
	(92) 出願日	平成 3 年(1991) 11			中小路 東京都	- 住史 品用区間	大世17日6番	

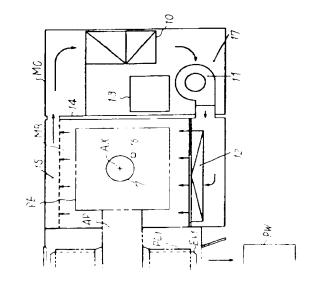
(54) 【発明の名称】露光装置

(57) 【要約】

【目的】 露光装置のスループットを向上させる。

【構成】 レチクルパターンをガラスプレートPTに転 写するための露光処理部PEを外気からほぼ遮断して収 納するメインチャンパーMCとは別に、露光処理部PE に搬入するきガラスプレートPTを収納したプレートき ※サプロのかせブチャンニー Sで特に集破する。 チャ investible of 00H, # theoree Schill 環境条件、特に温度を制御し、プレートキャリプPに わのサラスプモートPITの温度を断定値に設定する。

【効果】 露光処理部に搬送される前のカラスプレート PTの温度を最適温度、すなわらプレートステー、PS の温度とは好発して設定でき、露光処理部にはいて頂き にカッププレットに対する露光動作を開始するこうか可



【特許請水小範囲】

【請求項1】 マスクに形成されたハターンを感え基板 に転りするため内露光処理部と、前記感光基板を保持可 能な保持部材を少かくとも1つ有し、該保持部材に保持 された感光基板を前記露光処理部に搬入するとともに、 所記露光処理部で露光処理が随された感光基板を前記件 持部材まで搬出する基板搬送部とを外気が応ばほ進断し で収納する第1のチャンハーを備えた露光装置によい。

前記第1のチャンパートは別に、少な、とも前記露光処 10 サート等のある 理部に搬入すべき感光基板を保持した前記保持部材を外 気がにほぼ遮断して収納する第2のチャンパーと、該第 周辺の環境条件 2のチャンパー内に収納された前記保持部材の感光基板 には投影光学系の周辺の環境条件を制御する制御手段とを備えたことを で、投影光学系 特徴とする露光装置 美軸に得る こ

【請求項2】 前記制御手段は、前記第2のチャンパー 内の気体の少なくとも温度を制御するとともに、該制御された気体を前記保持部材に保持された歴光基板には手 治べて流す気体循環手段を含むことを特徴とする請求項 1に記載の露光装置

【請末項3】 前記制御手段は、前記第1のチャンパー 内の露光処理部に配置された感光基板、もしくはその場 辺でい温度に基づいて前記第2のチャンパー内の気体に 温度を制御することを特徴とする請求項2に記載り露光 装置

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、半導体素子や液晶表示 素子等を製造するための露光装置に関し、特に露光装置 を外気がらほぼ遮断して収納するチャンケー内の環境条 30 件を制御する装置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】近年、半導体素子や液晶表示素子製造のリックラフィ工程では、マスクまたはレチクル(以下、単にレチクルと称す)のハターンを感光基板(表面にレンスト層が形成された半導体ウエハやガラニアレートでは、大き、指導や露光装置。ス・・ハーン・デント・デリー・デス・カー、独立した。例えば武晶表が素子製造サウス・ハウーに、複数カレナクルを交換しなから各レナクルがデジンの像を投影光学系を介して等倍で、アレートス・ージをステッセングさせたからガラスプレート上に順次。なき合わせ、転写していく。これによって、カラスプレート上に画面合成。なき合わせ、されたり面積で回路のカーを呼ばばきた。ていく

1.1 有一、保持部村に保持されたカラファン、下下を露 えら理部に搬入する。ともに、露光が理部で露光に埋い 駆きれたカラスでレートを同一、または異なる保持部村 まで搬出する基板搬送部とが構成されている。保持部 村立しては、例立に複数位、10ト20枚程度、カヴラ ラファートを収納に確立し、下保管用さったで、ある いはスケートとついク・ラースロールートを子しび子 と信じたとき、プレート機はホーナクルタイムを調整す えために、時的にカラスでレートを収納するパップテカ

【0004】上記構成のスケーハーでは、投影光学系の 周辺の環境条件の大阪主、気温、湿度等にの変化、さら には投影光学系の露光光吸収による温度変化等によっ て、投影光学系の露光光吸収による温度変化等によっ で、投影光学系の結像特性。焦点位置、投影信率等にが 変動し得る。このため、装置全体(露光処理部及び基板 搬送部。を、一定温度の例えば23 よの、1 Cに、 一定の清浄度(例えばクラス10)に制御されたチャン 一一内に無気がにはば進出して収納している。しかも結 像特性に重要な影響を与える投影光子系のみを、高度に 温度制御された流体を用いてその温度を管理すること で、効果的に結像特性の変動を防止する技術も提案され ている。

[0005]

【発明が解決、ようとする課題】上記の如き従来技術に まいては、スケッパーを± 0. 1 (程度の精度で温度 制御されたチャンパーので使用しており、人手よたは基 板搬送装置によってキャリア単位、あるいは1枚毎にガ コスプレートをチャンパー内に搬入すると、ガラスプレ 一トはチャンパー内の温度とほぼ等しい温度に平衡す。 「る」ところが、露光処理部にフレートステージ(特にホ ルダ)は、ガラスプレートへのバターン露光の際にガラ スプレートを介してステージに伝導して蓄積される熱エ ネルギー、あるいはプレートステージの駆動系(例えば 送りねじ機構の場合、送りれしに螺合したナット)から 発生する熱等によって、チャン バー内の温度と異なる温 度に収斂している。たちため、基枚搬送装置して1~5万 けいこうきゃくさ に 散り出されて露 eres Village (* 1 支撑的现在分词 化自己温度设施 医缺失 胸壁的现在分词 1、 とんが一、小温度、はは30~温度に平衡すること 11.12.5

【0006】日 - 1、カンスコン - 5 5 温度の手動状態 ・なくまさは、カンスコンス - 1、おき他を起こし続け ストマンスの関係がみなると、きばれているケーン鑑字

⁻ Migrosoft (1997) | The House Company (東京中部) Marin (1997)

ing the second s

よっちょびょっちスケーショ かゆターディ温度能が無視 できる程度ない。(口口でありなる) 挽音すれば、カライ フレートの付法変化による。なぎ合わせ精度やアライメ シ ト精度の低手が所定の許容値(ハター)線幅等によっ り返する傾。以内となる。まて露光動作を停止させてむ () 巨要があるが、この何が時間が露光装置がスキーで トを低下させるという問題点がある。

【0007】本発明は以上の点を考慮してなされたもの できょ、露光処理部において感光基板が熱的に平衡制態 たはっなぎ合わせ精度にやスループットの低下を防止で きる露光装置を得ることを目的としている。

[0008]

【課題を輸送するための手段】とおる問題点を解決する ため収発明にはいては、レチグルRに形成されたハダー ンを感光碁板(ガラスフレート)PTに転写するためり。 露光処理部PEと、感光基板PTを保持可能な保持部材 ((7)レートキャリアP C_{ij} 、 (P,C_{ij}) にを少なくとも 1 ト 有し、保持部材PC」に保持された感光基板PTを露光 処理部PFに搬入するとともに、露光処理部PEで露光 20 処理が施された感光基板PTを保持部材PC。またはP C」まで搬出する基板搬送部PLとを外気が呼ばれる進制 」で収納する第1のチャンパーでメインチャンパー。M C を備えた露光装置において、第1のチャンパーMC と は別に、少なくとも露光処理部PEに搬入すっき感光基 板PTを保持する保持部材PC を外気から(日ぼ遮断) て収納する第2カチャンパー(サブチャンパー)SC と:第2カチャンバーSC内に収納された前記保持部材 力感光基板の周辺の環境条件を制御する制御手段(温度) 調節器20、チャンパーコントローラ100) とを設け、30 ることとした

[0009]

【作用】本発明においては、露光処理部等が収納された 第1のチャンパーとは別に、少なくとも露光処理部に搬 入すべき感光基板を保持した保持部材を外気さばは日間進 (表) で収納する第2つチャンパーを設けるとともに、第 2.5 f センコー内に収納された感光基板が閉じり環境等 4、 特に温度、多任むに制御可能に構成。

【0010】こうため、露き料理部に搬入される前の第 七草板で温度を、露光処理部内でステージョンのタール。4。 温度とほぼ等して設定することができる。従って、露る 処理部において感光基板が熱的に平衡状態となるまで壽 光動性を停止させておくと要わなくなり、アフィス。 ド (または、今き合わせ、精度を低下させることかで、盛 禁寒さん しょくしん おきんたん

是 main in MCC 医C内侧外侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧侧 されている。そそのチャンとデースを発明で第1とディン Note: MCは、1 きさかいターン をかけべけい いに結 像投影するために投影ととお示り等を有する露光処理部P 長年収録し、サブキャンティー教育時の第2の音中が八 - SCRPWがた、とうものでPC 、PC を含 今、キャリアPで、もりはPで、信候調されたかいべて 1 ーラケ露と処理部PEに搬入するトラギに、露光処理 部PFに露え処理の始された力がスプレットをキャリア となるまでのその呼ば変化によるアライメント精度しま。10、PC、またはPC まて搬出する基板棚に部ってに、大 ローターPILを収納している

> 【0012】 4実施例では、露光処理部PEに搬入する。 キカラスフレーをはキャリアPC に収納され、このか 一型プPC 147 取り出されて購入処理部PEでした。 シガ東,がされたガラスでは、ことはフレートロータPLに よってボモリアPC。に収納されるもりとする。また。 図 Lit はじょうにくている His As MC とせつだかいへ 一SCPの間でカラグブレートの無途が可能なように、 その境界の一部には開口部APが出成されている。

【0015】21---5キャリアPC 、PC は昇降可 能、すなどは、紙面と垂直な方向へ移動可能な支持部材E \mathbf{V}_{-} 、 $\mathbf{E}(\mathbf{V}_{+})$ に載道されておい 、支持部村E \mathbf{V}_{-} 、 $\mathbf{E}(\mathbf{V}_{+})$ |を下降されることには、で、曜SD | 、SD | を全1 で支持部科EV 、EV とキャリア機能用リコンPW との関クキャリア ${f P}C$ 、 ${f P}C$ 、 ${f P}C$ に続け渡しかけわれ そとまた、図1中にはサブチャンパーSC内、特に本実 施例では露え処理部PEに搬入すべきカラスフレートを 保持したフレートキャリ「PC」の周辺の環境条件(気 温、大気圧等しを検出する環境センサー26が配置され ている

【0014】尚、本実施例ではキャリアPC。内のガラ スプレート、もしくはその周辺の温度のみを検出できれ ば良く、例えばガラスプレート(またはキャリアPC) の温度を温度サンサーにより直接、もしては間接的に測 定するようにしても構わない。また。プレートキャリア 中で、厚くなさるでは、一を露光が理例や長げ搬入する 場合もあるなが、キャリスPC、この機にも環境セシャ 5 /5 /6

[0.011] - 5.11. O - O - VPT 15 Characters を食むを観覚されていませんでPC かたかけんは ○ トP年は無圧部材 とかしよりすりには、でその裏面を 真的機能されて取り出される。キャンプPロー的で複数 在食物工作,一种人类更过一种用一种种化。 $\{\Omega_{i,j+1}^{n},\dots,\Omega_{i,n}^{n}\}$ いてり、タスカモに相け移動させる。 もなににぬ実施物 and the transfer of the control of t

CHILD CONTRACTOR CONTRACTOR

[·]哈尔斯内森(艾克尔普)于1000年(1400年)。 一点 1777、大学、新兴 数据规模 人名英英克雷 医放射性

トアライメント機構するによって搬送アームチのに対してアライメントされる。アドアライメントされたカースフレートPTは、Z方向に移動可能な受け渡しケーフをテしてロードアームチ3に受け渡され、このロートアームチ3によって露光処理部PE内の所定位置に存機しているプレートスケーシPSにローティンクされてカルタPHに吸着される。受け渡しケーブルテとは、必要時にはカラスプレートPTを90。回転させてロートアームテ3に受け渡すことが可能となっている。

【 O O 1 7 】露光処理部PEでハケーンが転与されたカー10 ラスプレートPTは、搬送アームで O がフレートステー シ P S 上まで進入することにより取り出され、必要時に は受け渡しケーブル 7 2 上でカラスプレート P T を 9 O 回転させた後、キャリアP C (下) 1 に収納される 南、ガラスプレートの交換を高速化するため、カラスプレートの露光動作中に、次のカラスプレートをロートア ーム 7 3 に保持させておいても良い

【0018】決に 図4を参照し、露光処理部P上小属成を簡単に説明する。図4に示す装置のうち、少なくとも投影光学系7とプレートステーシ PSとはチャンパー 20 ルームMR内に配置されている。図4において、レチケルステージドSには4枚のレチクルド。~R、が保持されており、各レチケルはレーザ平津計5とチータ6とによって、投影光学系7の上左に設定される。レチケルド~R、の各々はレチクルステーシRS上でX、Y、6(回転)方向に微動可能に構成されており、3組のレチケルアライメント系3X、3Y、36(3Xはミラー4Xのみ図示)を用いてレチクルを微動することによって、レチクルは転写すべきパターン領域の中心点が投影光学系7の比軸AXとほぼ一致するように位置決めされる。

【0019】さて、レチクルR、を通過した照明光は両側テレセントリックな投影光学系でに入射し、投影光学系ではレチクルパターンの投影像を等倍で、表面にレシスト層が形成され、その表面が投影光学系での結像面とはは一致するように保持されたガラフで、一トPT上には機投影する。カラスでは、トアエには、トラスでは、トアント・セートが成了2次元移動可能に構成されており、カウスプレートPTに対するレデクルR、小転におり、カウスプレートPTに対するレデクルR、小転におり、カウスプレートPTに対するレデクルR、小転におり、カウスプレートPTに対するレデクルR、小転におり、カウスプレートアでは対するレデクルR、小転におり、カウスプレートアでは対するレデクルR、小転におきて、につきステーションを通過した場合によることでは、例えばり、01mm程度の分解能であり時間によれる。また、フレートステー・アドーは当時

やプレートストーンPSでの置き制御する他、装置主体 を発扬制御する。

【0020】され、図1の説明に展って、メインチャントーMCにおいて露光処理部PEは、HEPAフィルター12、仕切り、壁 14、フター、タクト15等で囲まれたチャントールーのMRのに配置されている。チャントールの最近では、全調機室17円に設けられた温度調節器10、ファン11、冷凍機13等によって、メインチャントーMCの自気体の空気の高温度を制御して循環されることで、所に温度の23 C程度に同調される。こと際、例えば投票光学をデか近候に配置された環境。または温度とセンザー16の利31が温度調節器10を制御することにより、チャントー・ークMR内内気温が所定温度に維持される

【0021】図1中に主じた実際は、メインチャンパーMC内で空気の流れる方向。苗環経路)を表しておしてヤンパールーのMR内ではサフチャンパールーのMR内で気を流す方向は任意で構わないが、当然ながたサブチャンパーSC、上なわが開口部APに向かないように流すことが望ました。南、温度とともにチャンパールーのMRに流入させる気体が引力策を制御して主良い

【0000】次に、「減りを蒸暖してサブチャンパーSC の具体的な構成と一個を説明する。[図2は[図1中に示し たぜ グチャン ペート ビを 出面 (ソコン PW り 炉回) さばに 見た様子を示しており、2組のプレートキャリアP C 、PC (不図形) とともにプレートローダPLは、 HEPAフィルター22及びリターンダクト25を介し | て少な、とも温度制御された気体(空気)が循環される チャンパールームSR内に収納されている。チャンパー ルームSR内の環境条件、特に露光処理部PEに搬入す べきガラスプレートが収納されたプレートキャリアPC の周辺の気温は、空調機室27内に設けられた温度調 節器20、ファン21、冷凍機23等によって、サブチ デントーSで内で気体。空気、小温度を開御して循環さ 様子でもの所の記憶に設定可能とならている。 ちゃいち Me 5000 (7) 模模 (または感覚) サーカーなど (4) 各位には露てい 新記PE問うで、アックリー、 1349 PSに設ける れた温度力シャー30~後げ、 り検出活果に基づいて、 チャントーロントロー 1100 (63) 小温度調節器の 6.を制御することにはいいまれる。

【0023】図2甲のおった明明は、サブチャンペート に世で現代制を表えるになっておくある。新聞機関しる

David Community (1997) (1997

私口、か習気で流れる方面・はほず行うな多くで、そう 内部に収納されたカースでレートで温度制能が対す向上 かために、例えばキャリアPC。PC で側面部 著 気の流れる方向とはほ垂直な面にで複数の孔(開口)を 形成してれる、温度制御された全気がキャリアPC。 PC 内が各カラスでレートにほぼ品。で流れるように 構成することが望ましい。また、チャンパールのSR 内で空気を流す方向は任意で良く、例えば四1中でキャ リアPC と呼ぶセリアPC。に向けて流すようにして も構わない。但し、HEPAフェルター22からり空気 10 がメインチャンパーMC、すたわも開口部APに向かな いように流すことが望ましい。

【00日4】さて、土記構成の装置では、図るに示けよ うにチャンパーコントローラ100が環境センサー1 6、26及び温度センサー3のの検出結果に基づいて温 度調節器10、20か各々を独立に制御し、チャンパー ルームMR、SR内を循環させる気体の各温度を任意に 設定することが可能となっている。従って、露光処理を 行うためにサブチャンパーS C C 格納されたフレートも ャリアPC。内のガラスフレートはストックとして保管。20c されると同時に、チャンパールームSR内の空気温度、 || はなわち露光処理部PE内のプレートステージ(正確に (はアレート載置面(ボルダ面)) の温度とほぼ等しい温 度に平衡していくことになる。このため、プレートキャ リアPC、内のガラスプレートをプレートステーシ上に ローディングする際には、カラスプレートとプレートス テージ (ホルダ) との温度差が既にほぼ客となってお り、プレートステージ上ではガラスプレートの付法変化 が生じないので、直ちに露光動作を開始することができ

【0025】以上の実施例においては、2組のブレートキャリアPCi、PC。及びブレートローダPLをサフチャンパーSC内に収納していたが、露光処理部PEに搬入すべきガラスブレートを収納したキャリアのみをサブチャンパーSC内に収納しても良い。例えばキャリアPC。に収納されたガラスブレートを、露光処理部PEでいない。1つ転的では、キャリアPCでは明まる場合には、キャリアPCでは発言では、キャリアPCでは発言では、キャリアPCでは発言では、オールーをサインには、オールーをサインには、オールーをサインには、オールーを行っている。コートをサインでは、オールーを行っているが、インチャン・プロートをサイチャン・プロートをサイチャン・プロートをサイチャン・プロートを行って、インチャン・プロートをサイチャン・プロートを行って、オインチャン・プロートをサイチャン・プロートをディスティン・プロートをディスティン・プロートをディスティン・プロートをディスティン・プロートをディスティン・プロートをディスティン・プロートをディスティン・プロートをディスティン・プロートをディスティン・プロートをディスティン・プロートをディスティン・プロートをディスティン・プロートをディスティン・プロートをディスティン・プロートをディスティン・プロートをディスティン・プロートをディスを開発しては、カラスプロートをディスティン・プロートをディスを使用しています。

1、ター・温度に思いてカウスプレート「温度を制御することとしたが、利きばフレートスケーンが温度をして値、すなわれのレートスケーンが温度をして値、すなわれのレートスケーンが温度を行っては、フェートの温度を制御すると要はない、利きばカケスフレートのは決定を最かでは、利きばカケスフレートのは決定によりかありません。この表明に定まる値には内しなるような温度範囲内にカケスフレートが温度を制御してなるな温度範囲内にカケスフレートが温度を制御してなるな温度範囲内にカケスフレートが温度を制御してなれば良い

【0027】また、上記実施例ではカナスフレートの温 度を所望の温度に制御するために、温度制御された官気 をサフチャントーSCB3苗環でせていたが、これ以外 い方法。例では露光処理部PEに搬入すべきカラスプレ 一人を収納したプレートキャドア はたばん・バステカセ とりに、またにはなりがっていたられ、とは手上樹子築の 温度調整主段によって加熱しまたは冷却ししてその温度 |を制御するようにしても良い||また、こりよくな構成を 採用する場合には特にサブチャンパーを設ける必要はな ()、露光処理部PE等とともにフレートキャリアPC をメイン チャントー 付け 収納ける こうかできる しじらん ながら、カラスフレートの温度制御精度を考慮すると、 ルなくともキャリアPC。をサラチャンパー内に配置す ることが望まりより 両、サブチャンパーSC内を循環さ せる気体は空気以外、例えばヘリウム等であっても良 い。また、温度制御された気体を循環させる方式以外。 に、カラスプレートの温度のみを直接、または間接的に 30 制御する場合には、気体の他に流体(水等)を用いても 構わない

i.o

【0029】また、アレートスケー、PSで温度調整核構を設け、例えばスケーンが温度が高に一定となるように制御しても構わない。この場合では、サフチャンパーSC内の温度制御(正確にはカラスプレートの温度制御。か非常に業になるといった利点がある。さらに積極的には、次にフレートスケーンとに載置されるカラスでしまり、温度を制御。であるのはでは、サフチャンパー等によって所定値に制御。10とも、次にフレートスゲーンとに載置されるカラスでは一トの温度を、サフチャンパー等によって所定値に制御。10とでいても、あるいはサフチャンパー等を設けず、全く制御していなくても良い。

【0031】尚、本発明においてメインチャンパー(第 1のチャンパー)の構成やその温度調整機構は任意で良 く、さらに露光処理部PEは投影型以外、例えばプロキ 30 シミティー方式等であっても構わない。また、本発明は 半導体製造用の露光装置に対して全く同様に適用でき る。

[0032]

【発明の効果】以上のように本発明によれば、露光処理

証、基板タテー」「搬送される町下密土草板は、遠土 地理部等を収納した第1 からゃ」が一片は駅に、水気か にほぼ連断されて第2 とうでしたが、露光処理部に 搬入された後に感え基板と温度と変にする。中なれられ 助に手術物態となる。まで、露光処理部である。いった 地理の得られる。また、露光処理部であれる。これ 温度に応じて第2からやしか一切が温度。中なおも感光 基板の温度を積極的に制御することによって、最早時間 で感光基板が温度を露光処理部で基板スケー」が 基板の温度を積極的に制御することによって、最早時間 で感光基板が温度を露光処理部で基板スケー」が 温度 とほぼ第1く設定することが可能となり、さらに露光装置 がスキーワートを向上させることができる。これと き、感光基板のよみ変化量が所定り許容値以内ないには ほぼ客となっているので、上記は出変化に起因したでか でメント構度が一など合わせ精度の低下も防止できる。

【民館の簡単な説明】

- 【図1】 4 発明の実施例による露光装置の概略的な全体 構成を分けば。

- 【図し】は1甲に水1 たサフチャンペー (第2のチャン - ペー) の具体的な構成 5 (例をかり図

【図3】 4 発明の実施例による露光装置。特に2組のチャンパーの制御系の構成が一例を示すプロック図

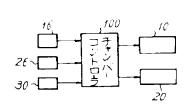
【図4】露光処理部の具体的な構成を示すや面図

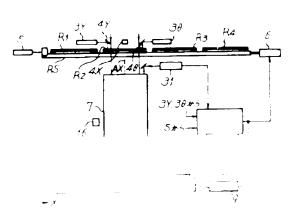
【図5】基板無圧部(アン・トロータ)の具体的な構成 を2017年検団

【符号/部門】

$1.0 \div 2.0$	温度調節器
11,21	7773
12,22	HEPATZA4-
1.6 \ 2.6	- 環境センサー(温度センサー)
3.0	温度センサー
PΕ	露光処理部
PI.	基板搬送部
PC_{-} , PC_{-}	フレートキャリア
1 () ()	チャンペーマントローチ

(1001





[[4]1]

